

盈方微电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司的发展战略，恪尽职守、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，推动了公司健康、稳定发展。

现将 2021 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2021 年度经营发展情况

2021 年度，国内疫情虽有反复但整体可控，经济稳步发展。自完成对华信科和 World Style 51%股权的收购后，公司首次实现对电子元器件分销业务的全年并表。公司芯片研发设计业务的发展逐步进入正轨，并将与电子元器件分销业务形成良好的协同效应，公司整体经营保持稳定发展的态势。

报告期内，公司坚持“稳业务、促上市、推重组”的经营目标，全体董事群策群力、全力以赴积极推动各项工作的稳步实施。在符合恢复上市条件之后，公司第一时间向交易所提出了恢复上市的申请，并对交易所的相关问询问题进行逐项落实。为进一步提升公司盈利能力，公司在报告期内积极推动发行股份购买华信科和 World Style 剩余 49%股权的重大资产重组工作。如本次重大资产重组实施完毕，公司的电子元器件分销业务将进一步实现与芯片研发设计业务的充分融合，实现相辅相成、并进发展，夯实公司对产业链的纵向整合布局。

报告期内，公司持续跟进重大诉讼的进展情况，及时参加相关诉讼开庭，全力收集各项有力证据，为公司争取合法利益。公司两项重大担保诉讼案件均在报告期内实现了一审判决，相关判决结果充分符合公司预期，公司重大诉讼的赔付风险进一步降低；报告期内，公司同步跟进、协调荆州公安对公司的立案侦查事项，促成相关立案事项审查终结；此外，公司不断加强内部合规性管理，促进业务流程优化和管理增效，公司的治理水平显著提升。

报告期内，公司实现营业收入 289,002.79 万元，比上年同期增长 312.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 323.77 万元，比上年同期减少 68%。

（一）主营业务发展情况

1、芯片设计业务发展情况

报告期内，公司根据头部客户需求，积极推动芯片投产工作。同时积极开拓新客户，通过对软件系统的优化解决了原有库存产品的迭代问题。公司积极把握市场契机，专注新一代芯片的开发，以满足外部主流产品市场的规格需求。公司依托自身在智能影像处理终端 SoC 芯片领域技术积累，持续增加研发投入，不断提高创新能力，逐步拓展公司在智能影像 SoC 芯片消费市场多项应用领域的布局。报告期内，公司本着研发创新为发展基石的经营理念，大力推进公司自主研发力度，专注提升公司产品中自主研发比率，全面融入国家的芯片国产化进程。2021 年公司研发费用为 1,934.84 万元，较去年同期增长 310.12%。报告期内，上海盈方微新增若干项专利申请，截至目前，上海盈方微累计获得国内专利授权近二十项。

2、电子元器件分销业务发展情况

深圳华信科和 World Style 已拥有一批知名电子元器件品牌的代理权，代理的产品类别涵盖指纹芯片、射频芯片、电源芯片、被动元件、综合类元件等，服务于包括小米、闻泰、丘钛等优质客户。

报告期内，深圳华信科和 World Style 在继续专注于现有市场和客户服务的同时，积极洽谈和引进新的优质产品线。目前，公司新增了 SHOULDER 和 SMARTSENS 的产品代理权，公司分销业务的内生发展动能持续增强。报告期内，华信科和 World Style 从采购、库存等环节实施质量控制，所代理的产品均经过相关国际标准检验和认证，产品经原厂制造商严格的质量控制和包装，确保了所代理产品的质量和安全环保要求。

（二）恢复上市进入核查阶段

报告期内，公司及时提交了恢复上市的申请，且获得深交所受理；积极组织各方力量释疑监管问询，主动对接监管机构对公司恢复上市的后续核查程序，并有效落实相关问题，促进恢复上市相关工作提前规划、稳步实施。目前，公司处于恢复上市的现场核查期间，公司将积极配合监管机构的核查工作，争取早日实现恢复上市。

（三）重大重组完成材料申报

为进一步提升上市公司的盈利水平，深化和华信科、World Style 的整合，充分发挥芯片业务和电子元器件分销业务在产业链上下游的协同效应，公司在报告期内筹划实施发行股份购买华信科和 World Style 剩余 49% 股权并同步募集配套资金的重大资产重组事项。公司分别召开董事会、监事会、股东大会审议通过了《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2022 年 1 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（213605 号，以下简称《补正通知书》），公司将按照《补正通知书》的要求，积极准备补正材料并及时报送。

（四）公司治理获得有效提升

报告期内，公司持续强化各项管理工作，持续推动芯片研发和分销业务的进一步整合，推动业务实现不断开源。同时，公司积极梳理，优化从研发、采购、运营、财务、销售等环节的业务流程，促进资源的科学配置，提升公司的整体经营效率。报告期内，公司统筹规划资金预算，严格执行资金使用计划，提升资金使用效率；持续推动健全和完善内控建设，优化各项管理制度，提升公司的治理水平，促使公司保持健康、稳定发展。

（五）人才建设取得积极成效

专业的人才集成电路设计企业发展壮大的基石。报告期内，公司重点加大研发投入和完善研发体制，现已形成较为稳定的研发梯队，核心管理团队架构稳定，梯队层次合理，知识结构互补。公司还通过积极宣贯，来增强员工对公司的企业文化的认同感和归属感，提高员工的工作积极性。

二、董事会履职情况

报告期内，公司董事会切实履行各项职责，勤勉地开展工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议了 64 项议案，就公司定期报告、会计政策变更、内控自评、聘任会计师事务所、董事及高管薪酬、关联交易、提供担保、重大资产重组、重大投资、申请恢复上市等重大事项进行了审议，所有会议的召集、召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，各参会董事对议案进行充分的讨论并发表意见，所有关联交易均在事前取得独立董事的

认可,在审议关联交易时,关联董事按规定进行了回避表决。各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

(二) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据相关工作细则在董事会授权范围内开展工作,为董事会决策提供咨询、建议。

战略委员会听取了董事长兼总经理的经营汇报和战略规划说明,听取了公司重大资产重组和申请恢复上市的相关汇报并对公司对外重大投资事项进行审议;审计委员会 2020 年度召开了 9 次会议,主要对各定期报告、聘任会计师事务所、关联交易、内部控制、重大资产重组等事项进行了专项审议并发表意见,同时审计委员会各委员保持与年审会计师密切沟通,督促年度审计工作按时完成以出具审计报告;薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的年度履职进行考核,并根据工作绩效确认薪酬发放。

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事严格遵守有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,认真、勤勉地履行了独立董事的职责,积极参与公司重大事项的决策,充分发挥自身的专业优势和独立作用,对报告期内公司关联方资金占用和对外担保的情况、关联交易、内控报告、利润分配、聘任会计师事务所、重大资产重组、申请恢复上市、计提资产减值准备等重大事项发表了客观、公正独立意见;对聘任会计师事务所、关联交易、重大资产重组等事项进行了事前审查,发表了事前认可意见,切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

(四) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

公司董事会严格按照股东大会的授权,认真执行了股东大会审议通过的各项决议。报告期内,公司共召开 2 次股东大会,会议审议情况如下:

届次	召开时间	审议议案
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 24 日	1、《公司 2020 年度董事会工作报告》 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》 3、《公司 2020 年度财务决算报告》 4、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 5、《公司 2020 年度利润分配预案》 6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

		<p>7、《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>8、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>10、《关于以债权转股权方式向全资子公司增资的议案》</p>
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 12 月 27 日	<p>1、关于公司重大资产重组首次董事会决议公告后 6 个月内未发布召开股东大会通知有关事项说明的议案</p> <p>2、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案</p> <p>3、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（调整后）</p> <p>3.01、本次交易方案概述</p> <p>3.02、交易对方</p> <p>3.03、标的资产</p> <p>3.04、标的资产定价依据及交易价格</p> <p>3.05、发行股份的种类和面值</p> <p>3.06、发行方式及发行对象</p> <p>3.07、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格</p> <p>3.08、发行数量</p> <p>3.09、锁定期安排</p> <p>3.10、上市地点</p> <p>3.11、盈利承诺及利润补偿</p> <p>3.12、期间损益安排</p> <p>3.13、滚存未分配利润安排</p> <p>3.14、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任</p> <p>3.15、发行股份购买资产决议有效期</p> <p>3.16、发行股份的种类和面值</p> <p>3.17、发行对象、发行方式及认购方式</p> <p>3.18、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格</p> <p>3.19、发行数量</p> <p>3.2、锁定期安排</p> <p>3.21、上市地点</p> <p>3.22、募集配套资金金额及用途</p> <p>3.23、发行股份募集配套资金决议有效期</p> <p>4、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案</p> <p>5、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案</p> <p>6、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>7、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案</p> <p>8、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>9、关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案</p> <p>10、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协</p>

		<p>议及《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案</p> <p>11、关于签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案</p> <p>12、关于《盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案</p> <p>13、关于本次重大资产重组有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案</p> <p>14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案</p> <p>15、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案</p> <p>16、关于本次重大资产重组摊薄即期回报的情况及填补措施的议案</p> <p>17、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案</p> <p>18、关于《盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的议案</p> <p>19、关于无需编制前次募集资金使用报告的议案</p> <p>20、关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案</p> <p>21、关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案</p> <p>22、关于修订《募集资金管理办法》的议案</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司股东大会全部采取网络与现场会议相结合的投票方式，并对中小投资者的表决单独计票；审议关联交易提案时，相关关联股东已进行了回避表决；对于特别决议事项，均已取得有效表决权股份总数的三分之二通过。董事会按照法律、法规的要求，确保股东大会对每项议案进行了充分讨论，股东大会的各项决议均已得到严格执行或实施，有力维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，遵循了“真实、准确、完整、及时、公平”的原则披露各项重大信息。报告期内，公司及时披露定期报告和各类临时公告，持续关注公司重大资产重组事项、恢复上市事项、业务发展情况、关联交易、重大诉讼、立案侦查等事项的进展情况，持续履行进展披露。报告期内，公司共披露公告及各类文件 221 份。公司严格执行内幕信息管理规定，所有重大信息在披露前严格保密、控制知情范围并对相关知情人员进行了登记管理，报告期内未发生内幕信息泄露情形。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司以董事会办公室为窗口建立了多渠道的投资者沟通方式，通

过投资者互动平台、咨询电话、投资者邮箱、投资者接待日活动等方式与投资者建立沟通，回复投资者的各类询问并向管理层传达投资者对公司发展的各类建议、意见，在增进投资者进一步了解公司发展方向、事件进展的同时，也进一步加强了投资者的认可。公司积极做好各类投资者教育和宣传工作，在交流中倡导投资者坚持价值投资。

三、公司未来发展展望

（一）行业格局及发展趋势

在全球半导体市场快速增长的带动下，我国作为全球最大的信息电子产品制造和消费大国，集成电路的市场也逐渐地上升到全世界最大的消费市场。2020年中国集成电路进口金额达3500.4亿美元，较2019年增加了445亿美元，2021年1-11月中国集成电路进口金额已达3890.6亿美元，同比增长23.4%；2020年中国集成电路出口金额为1166.0亿美元，较2019年增加了150亿美元，2021年1-11月中国集成电路出口金额为1381.2亿美元，同比增长34%。

集成电路产业作为现代信息技术产业的核心，其涉及诸多产品种类，是支撑我国国民经济发展、保障国家安全的战略性和先导性产业，也是促进我国高技术制造业转型升级、实现高质量发展的关键力量，其所派生出的PC、互联网、物联网、大数据、云计算和人工智能等一大批信息技术产业已经渗透到了政治经济生活的各个领域，成为当前全球竞争的焦点所在。

十四五规划期间，关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的一系列政策的不断出台，再次向全国、全球的企业和人才传递出持续发展集成电路和软件产业的恒心、大力延揽专业人才的决心及全力提升产业自主创新能力的雄心。目前，集成电路产业整体规模仍处于持续扩张时期，集成电路和软件产业精准施策，吸引社会投资者、聚集丰富社会资源，为集成电路产业可持续长远发展提供人才技术保障以及资金支持。

盈方微作为中国半导体产业的一员，目前处于国内集成电路产业综合水平高、产业链完整、产业生态环境好的集聚地上海，亦积极在芯片设计、自研算法等领域加速创新，结合贴近国内市场的优势，为客户研发高性价比的芯片产品。

电子元器件分销为集成电路制造行业的下游行业，是产业链中连接上游原厂制造商和下游电子产品制造商的重要纽带，是产业链中不可或缺的中间环节。当

前，疫情影响导致国外部分电子元器件企业生产经营受阻，也促使海外订单不断向国内转移，这给国内电子元器件相关企业借以占领市场的机会。随着下游消费电子、汽车电子、物联网等应用市场的高速发展，国内电子元器件相关企业顺应形势、勇抓机遇，市场份额得到不断提升，国内电子元件企业在全球的影响力与日俱增。

（二）公司未来发展战略

公司未来将充分利用现有技术储备和经验积累，坚持以芯片自主研发为策略，逐步拓展SoC芯片应用方向，向物联网智能影像芯片的应用领域拓展并打造自己的核心技术与创新力量；同时，积极抓住芯片进口替代的产业契机，力争打入主流手机、智能设备等厂商的供应链，进一步加大芯片分销业务的开拓力度，增强公司在智能电子元器件领域的综合实力和影响力，有效促进芯片设计与分销业务协同发展、相辅相成，逐步凝聚公司的核心竞争力；此外，公司还将依托现有资源，通过并购、对外投资和业务协同等方式进行产业整合，推动公司实现持续、健康、快速的发展。

四、公司 2022 年经营计划

1、芯片设计

公司的芯片产品主要面向影像处理领域。随着物联网快速普及，人工智能、传感器等技术迅速迭代升级，图像智能终端将迎来加速发展期。而高清图像处理应用领域的需求不仅专注于单纯的图像处理性能，还要结合高性能的图像系统以及音频系统，实现各种智能化的场景应用。基于此，公司芯片业务将依托相关技术积累，深入探索消费类电子领域的市场需求，进一步对图像处理系统的性能进行升级，打造高度智能化的消费级物联网芯片，谋划芯片应用功能向无人机、智能楼宇的可视化系统、视频会议系统、车载记录仪、教育机器人、智能门铃等行业延伸。通过不断优化、完善相应的商业模式，促进公司芯片业务实现跨越式发展。

2、电子元器件分销业务

2022 年，公司将对内强化管理，对外加强服务和品牌推广力度，通过“内外兼顾”的工作提升，不断加强电子元器件分销领域的内外部资源整合，促进华信科和 World Style 在分销业务领域的管理能力、风控能力、运营效率、服务质

量等方面的进一步提升，持续增强公司分销业务的核心竞争力。同时，在分销业务现有客户和供应商资源的基础上，努力加强市场拓展，积极扩充产品线资源和客户群，促进分销业务健康、稳健发展。华信科和 World Style 还可借助上市公司的平台优势，顺应 5G 潮流和国产替代趋势，充分发挥本土分销商在物流、技术、市场理解等方面的优势，逐步向智能家居、新能源汽车等领域渗透，进一步扩大公司分销业务的市场份额，打造规模化优势。

3、继续推进发行股份购买资产并募集配套资金交易

公司发行股份购买华信科和 World Style 剩余 49%股权并同步募集配套资金的重大资产重组事项已提交中国证监会审核，公司正根据证监会《补正通知书》的要求积极准备补正材料。2022 年度，公司将根据后续审核进展情况及时履行信息披露；同时，公司将积极关注本次重大重组的各相关环节，超前筹划、未雨绸缪，力争促使本次交易顺利实施。

4、力争实现恢复上市

目前，公司恢复上市处于恢复上市的现场核查期间，公司将积极配合监管机构的核查工作。同时，公司将不断加大主营业务的开拓力度，促进芯片研发设计和电子元器件分销业务的进一步整合，提升持续经营能力，争取早日实现恢复上市。

5、择机推动其他资本运作事项

公司主业聚焦于集成电路行业的芯片研发设计和元器件分销，公司已在当前业务领域内积累了一定的技术和资源优势。未来，公司可择机开展多种资本运作手段，通过产业兼并、重组、投资等方式进一步整合，运用公司内外部的资源，为公司长期、健康、高速发展奠定坚实基础。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日